



7.30.(월) 09:00부터 보도하여 주시기 바랍니다.

배포일시	2018. 7. 30.(월)	담당부서	산업통상자원부 전자부품과
담당과장	박영삼 과장(044-203-4270)	담당자	이정남 사무관(044-203-4273)

## 백운규 산업부장관, SK하이닉스·삼성전자 반도체 공장 방문 - 반도체 산업정책 추진 성과·전략 발표 및 업계 애로사항 청취 -

- 백운규 산업통상자원부 장관은 7. 30.(월) 에스케이(SK) 하이닉스 이천공장과 삼성전자 평택공장을 연이어 방문해 그간 반도체 산업정책 추진성과와 향후 중점 추진전략을 발표하고, 업계 애로사항을 청취하는 등 업계와의 소통을 이어간다.
- 이번 현장방문은 올 상반기 우리나라 수출의 20% 이상을 담당하고 있는 반도체 업계를 격려하고 경쟁국 추격에 따른 위협요인 대응방안 등 반도체 산업정책 방향을 논의하기 위해 이루어진다.

### < 반도체 업계 방문 개요 >

#### < SK하이닉스 이천공장 >

- 일시 : '18.7.30일(월) 09:00~10:20(80분)
- 주요 참석자 : 산업통상자원부 백운규 장관, 소재부품산업정책관  
SK하이닉스 정태성 사장

#### < 삼성전자 평택공장 >

- 일시 : '18.7.30일(월) 11:20~13:00(100분)
- 주요 참석자 : 산업통상자원부 백운규 장관, 소재부품산업정책관  
삼성전자 진교영 사장

□ 반도체 산업은 우리나라 경제에서 차지하는 비중\*이 날로 높아지고 있으며, 4차 산업혁명의 영향으로 고성능 반도체의 수요가 증가해 중요성이 더욱 커질 것으로 예상된다.

\* '17년 단일품목 최초로 수출 100조원(979억불)을 돌파, '18년 1,250억불 수출 예상

○ 하지만, 최근 중국 반도체 굴기 등 경쟁국의 추격\*과 함께 메모리 반도체 시장가격이 조정상태를 보이고 있어 메모리반도체의 '수퍼사이클'이 조기 마감될 수 있다는 전망도 있다.

\* (예시) YMTC : 약 240억 달러 투자, '18년 하반기부터 3D 낸드 양산 추진 중

○ 더구나 메모리를 제외한 시스템반도체 분야는 특허, 설계, 제조 등 모든 경쟁요소가 취약한 상태가 지속되고 있는 상황이다.

## < 반도체 산업정책 추진 성과 >

□ 백운규 장관은 모두 발언을 통해 대외적 위협요인에 대응하고 우리 반도체산업의 국제 경쟁력 유지를 위해 지난 2. 8. 발표한 '반도체 산업 발전전략'에 따라 정책을 강력히 추진해왔다고 말했다.

○ 먼저, 범부처 대규모 '차세대 지능형반도체 기술개발사업' 기획을 완료하고 예비타당성 조사를 추진 중\*에 있으며,

\* 산업부·과기정통부 공동으로 향후 10년('20~'29)간 1.5조원 규모의 차세대 기술 개발사업 예타 추진 예정('18.하반기)

○ 국제 소재·부품·장비기업 육성을 위한 성능평가 대상 품목을 대폭 확대('17년 7건→'18년 61건)하고, 1차 시험시공(Test-bed)에서 2차 대기업 양산라인으로 이어지는 단계적 성능평가 체계를 마련해 왔다.

○ 또한, 반도체 전문인력 양성사업을 지속 추진\*하고, 반도체 설계 개발 전문 회사(팹리스: Fabless) 기업 지원을 위해 '전자부품 융합 얼라이언스'를 출범\*\*해 수요산업과 반도체산업 간 협력체계를 구축했다고 말했다.

\* 지능형반도체 전문인력양성 : ('18) 비학위형 930명, 학위형 120명, 61억원 지원

\*\* 자동차 분과(5.31), 바이오·의료기기 분과(6.26) 융합얼라이언스 출범 완료

## < 반도체 산업정책 중점 추진 전략 >

- 백 장관은 우리나라의 세계 반도체 1위 달성을 위해 하반기에도 반도체 산업정책을 강력 추진하겠다는 의지를 보이며 앞으로의 반도체 산업정책 3대 중점 추진전략을 밝혔다.
  - 먼저, 미세화 한계에 도달한 디램(DRAM), 낸드 등 기존 메모리반도체를 대체할 수 있는 차세대 메모리소자(device)와 소재(material) 개발을 지원하고,
  - 4차 산업혁명시대의 새로운 성장동력으로 시스템반도체(SoC)를 육성해 이를 통해 반도체 설계 개발 전문회사(Fabless)와 반도체 제조를 전담하는 생산 전문 기업(파운드: Foundry) 산업 활성화를 추진하겠다고 말했다.
    - \* 창업공간부터 기술지원, 시제품제작, 투자, 인력유치까지 일괄지원하는 '시스템 반도체 설계지원센터' 구축·운영('18.하반기)
  - 다음으로 세계 반도체 소재장비기업\*의 생산라인 국내 유치 확대를 통해 우리나라의 글로벌 반도체 제조 거점(Hub) 국가화를 추진할 계획으로,
    - \* (소재) MEMC(Global Wafers, 타이완), Airproduct(가스류, 미국) 등
    - \* (장비) ASML(네), AMAT(미), KLA-Tencor(미), LAM Research(미), TEL(일) 등
    - 외국인 투자에 대한 지원 확대 등 투자유치 지원제도를 개편\*하고 범정부적 차원에서 정주여건 개선, 입지·환경 규제개혁을 추진하며
    - \* 외국인투자에 대한 현금지원 확대, 조특법 개정 통한 신산업 분야 세액공제 확대 등
    - 우수인력 공급, 첨단기술 개발, 설계·제조 활성화 등 반도체 공급사슬(Supply Chain) 강화를 통한 선순환적 생태계를 구축하겠다고 말했다.
- 한편 백 장관은 에스케이(SK) 하이닉스, 삼성전자가 협력사와의 상생을 위해 추진중인 성능평가 지원, 공동기술 개발, 자금지원, 기술교육 등의 노력을 지속해 줄 것을 당부하면서,
  - 정부에서도 민간의 투자가 적기에 이루어질 수 있도록 관련 애로를 적극적으로 해소해 나갈 것이라고 약속했다.

- 백 장관은 “4차 산업혁명 시대를 맞아 향후 반도체의 역할이 더욱 중요해질 것이며, 민관이 적극적으로 협력하여 경쟁국의 추격을 따돌리고 세계 1위를 유지해 나가자.”라며,
- “지난 12대 기업 최고경영자(CEO) 간담회(7.16)에서 강조한 ‘기업을 위한 산업부(Ministry for Enterprise)’가 되기 위한 노력을 말 뿐이 아닌 행동으로 실천하기 위해 오늘과 같은 **현장소통을 지속하겠다.**”라고 강조했다.

※ 현장사진은 별도 배포 예정

 <p>공공누리 공공저작물 자유이용허락</p>	<p>보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 전자부품과 이정남 사무관(☎ 044-203-4273)에게 연락주시기 바랍니다.</p>
---	--